## 履歴書

## 写真を貼る位置

			1. 縦 36~40 mm
ふりがな		そん うどう 男	横 24~30 mm
氏 名		孫 宇同	2. 本人単身胸から上 3. 裏面にのりづけ 4. 裏面に氏名記入
生年月日		平成 10 年 11 月 22 日生 満(26)歳	
ふりがな	•		(自宅電話)
現住所	₹	中华人民共和国	
			(携帯電話)
E-mail		zxi09180@gmail.com	353-874861954
ふりがな			(連絡先電話)
連絡先	Ŧ	同上	同上

年	月	学歴・職歴 (各別にまとめて書く)
2019	9	東華大学 国際経済貿易と日本語専攻 入学
2023	6	東華大学 国際経済貿易と日本語専攻 卒業
2023	9	ゴルウェイ大学 ソフトウェア設計と開発学位課程 入学
2024	6	ゴルウェイ大学 ソフトウェア設計と開発学位課程 卒業
		職歴
2023	1 0	Medtronic インターンソフトウェアエンジニア 入社
2024	4	Medtronic インターンソフトウェアエンジニア 退職
-		

年	月	免許・資格
2022	6	IELTS 7. 5
2025	1	日本語能力試験1級 取得

## 志望の動機

私は、SpringBoot や React をはじめ、バックエンドおよびフロントエンドの開発技術に精通しております。さらに、iOS および Android のネイティブアプリ開発にも携わり、Java/Kotlin (Android) や Swift (iOS) を用いたモバイルアプリの開発経験があります。加えて、Docker や Kubernetes を活用したシステムのデプロイ、ELK スタックによる監視など、幅広い技術に対応できます。

本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入)

貴社の規定に従います。